PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

10-077321

(43)Date of publication of application: 24.03.1998

(51)Int.CI.

CO8F291/00 CO8F 2/44 C08L101/00 GO2B 1/04 // CO8F 20/38

(21)Application number: 09-056009

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing:

11.03.1997

(72)Inventor: SAKAI AKIHIKO

KUBOTA TETSUYA

(30)Priority

Priority number: 08179116

Priority date: 09.07.1996

Priority country: JP

(54) RESIN COMPOSITION AND MEMBER OBTAINED BY CURING THE SAME BY ACTIVE **ENERGY RAY**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resin composition comprising an amorphous thermoplastic resin and a specific bis(meth)acrylate, excellent in chemical and thermal resistances and suitable as an optical lens, etc., instead of a glass base.

SOLUTION: This resin composition comprises (A) 99-1wt.% amorphous thermoplastic resin and (B) 1-99wt.% bis(meth)acrylate curable by active energy rays. Preferably, the component A is an amorphous polyolefin, especially a ring-opening polymer or its hydrogenated polymer of tetra-3-dodecen having a polar group or its derivative, and the component B contains at least one kind of bis(meth)acrylate selected from compounds of formula I [R1 and R2 are each H or methyl; R3 and R4 are each a 1-6c hydrocarbon; X is a halogen, a 1-6C alkyl, etc.; (a) is 0-4] and II [R5 and R6 are each H or

T

ì

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

methyl; (b) is 1 or 2; (c) is 0 or 1].

24.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3540115 02.04.2004

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-77321

(43)公開日 平成1 0年(1998) 3月24日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C08F291/00	MPZ		C08F291/00	MPZ	
2/44	MCS		2/44	MCS	
C08L101/00	KAS		C08L101/00	KAS	
G02B 1/04			G02B 1/04		
// CO8F 20/38	MMU		CO8F 20/38	MMU	
			審査請求 未請案	求 請求項の数9	OL (全10頁)
(21) 出願番号	特願平9-560	0 9	(71)出願人 00	0005968	
			三菱	化学株式会社	
(22)出願日	平成9年(199	7) 3月11日	東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号		
			(72)発明者 坂井	昭彦	
(31)優先権主張番号	特願平8-179	1 1 6	茨 城	県牛久市 東猯穴町	1000番地 三菱
(32)優先日	平8 (1996)	7 月 9 日	化学株式会社筑波事業所内		
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者 久保	田 哲哉	
			茨切	県牛久市東猯穴町	1000番地 三菱
			化学	株式会社筑波事業	所内
			(74)代理人 弁理	4 医公川 瞬刻	

(54)【発明の名称】樹脂組成物及びこれを活性エネルギー線により硬化させてなる部材

(57)【要約】

【課題】 光学レンズ、光ディスク基板、液晶基板、カラーフィルタ、太陽電池基板、タッチパネル、光学素子等のガラス基板に代えて、耐薬品性に優れておりガラス基板より衝撃強度においても優れた樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 非晶質熱可塑性樹脂 $9.9 \sim 1$ 重量%と活性エネルギー線により硬化可能なピス(メタ)アクリレート $1 \sim 9.9$ 重量%とよりなる樹脂組成物及びこれを活性エネルギー線により硬化させてなる部材。

【請求項4】

【請求項5】

記載の樹脂組成物。

物。

テトラー3ードデセンもしくはその誘導体又は/及び極

性基を有するピシクロヘプトー2ーエンもしくはその誘

導体と他の環状オレフィンとの開環重合体又はこれら開

(メタ) アクリレートが下式 (1) 及び (2) より選ば

れた少なくとも1種のビス(メタ)アクリレートを含ん

でなることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに

環重合体の水素添加物である請求項2記載の樹脂組成

非晶質ポリオレフィンが極性基を有する

活性エネルギー線により硬化可能なピス

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非晶質熱可塑性樹脂99~1重量%と活性エネルギー線により硬化可能なピス(メタ)アクリレート1~99重量%とよりなる樹脂組成物。

【請求項2】 非晶質熱可塑性樹脂が非晶質ポリオレフィンであることを特徴とする請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項3】 非晶質ポリオレフィンが極性基を有する テトラー3ードデセンもしくはその誘導体又は/及び極 性基を有するピシクロヘプトー2ーエンもしくはその誘 導体の開環重合体又はこれら開環重合体の水素添加物で ある請求項2記載の樹脂組成物。

[式 (1) 中、R'及びR'は、互いに異なってもよく、水素原子又はメチル基を示す。R'及びR'は、互いに異なってもよく、炭素鎖中に酸素原子及び/又は硫黄原子を有してもよい炭素数 $1 \sim 6$ の炭化水素基を示す。Xはハロゲン原子又は炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基及び炭素数

1~6のアルコキシ基から選ばれた置換基を示し、aは0~4の整数を示す。但し、aが2以上の整数の場合には、複数のXは互いに異なってもよい。]

【化2】

$$\begin{array}{c}
R^{5} \\
CH_{2}=C-C-O-CH_{2} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^{6} \\
1 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2}-D-C-C-C+H_{2} \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_{2}-D-C-C+C+H_{2} \\
0
\end{array}$$

30

50

2.0

[式(2)中、R⁴及びR⁴は、互いに異なってもよく、 水素原子又はメチル基を示す。 bは1又は2を示し、c は0又は1を示す。]

【請求項6】 非晶質熱可塑性樹脂の屈折率とピス(メタ)アクリレートを活性エネルギー線により硬化した樹脂の屈折率との差が0.05以下であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の樹脂組成物。

【請求項7】 非晶質熱可塑性樹脂99~1重量%と活性エネルギー線により硬化可能なピス(メタ)アクリレート1~99重量%とよりなる樹脂組成物を活性エネルギー線により硬化させてなる部材。

【請求項8】 アイゾット衝撃強度が0.5 kgf・cm/cm以上であることを特徴とする請求項7記載の部材。

【請求項9】 部材がシート状又はフィルム状に成形されてなり、部材の平行光線透過率が80%以上であることを特徴とする請求項7又は8記載の部材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐薬品性、耐熱性 の良好なガラス代替用樹脂組成物及び該樹脂組成物を活 性エネルギー線により硬化した部材に関するものであ り、例えば、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、プラスチック液晶基板、プラスチックカラーフィルタ、プラスチック太陽電池基板、タッチパネル、光学素子等に 好適に利用できる。

[0002]

【従来の技術】従来より、ガラス代替用途としては、非晶質熱可塑性樹脂が透明性の点から使用されてきている。しかしながら、非晶質熱可塑性樹脂は耐薬品性に劣ること、また耐熱性についてもガラス転移温度以上では流動してしまうため使用できる範囲が限定されるという問題がある。そのため、特開平6-116406号には、耐薬品性を改良する目的で非晶質熱可塑性樹脂層の表面に光硬化性樹脂層を設けたものが提案されているが、該光硬化性樹脂層が外力等によって傷ついた場合、溶剤等により容易に膨潤および溶解してしまうという欠点がある。

【0003】一方、一般に耐熱性改善の目的で熱可塑性 樹脂に過酸化物を添加して、熱可塑性樹脂を架橋する方 法が提案されているが、この場合、樹脂自体を反応させ るため使用できる樹脂が限定されてしまい、現状ではポ リエチレン樹脂に使用されているに過ぎず、非晶質熱可 塑性樹脂を架橋することにより耐熱性を向上させること

が困難である。他方、 光硬化した樹脂自体は、耐薬品性 に優れているが、耐衝撃性に劣るため成型物が薄物の場 合、割れやすいとい う欠点がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記事情に 鑑みガラス基板に代えて、透明板、光学レンズ、光ディ スク基板、プラスチック液晶基板、プラスチックカラー フィルタ、プラスチック太陽電池基板、タッチパネル、 光学素子等に好適に利用できる樹脂組成物及び部材を提 供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本願発明は、非晶質熱可塑性樹脂99~1重量%と活性エネルギー線により硬化可能なピス(メタ)アクリレート1~99重量%とよりなる樹脂組成物に関し、また本願発明の請求項 6 記載の発明は、該樹脂組成物を活性エネルギー線により硬化させてなる部材に関する。以下、本発明を詳細に説明する。

【0006】本発明の樹脂組成物は、非晶質熱可塑性樹 脂と活性エネルギー 線により硬化するビス (メタ) アク リレートとからなる。本発明の非晶質熱可塑性樹脂と は、X線解析法による結晶化度が5%以下のものであ り、具体的にはPS (ポリスチレン)、SAN (スチレ ンーアクリロニトリ ル共重合体)、PC(ポリカーボネ ート)、PMMA (ポリメチルメタクリレート)、PE S(ポリエーテルス ルフォン)、PAR(ポリアリレー ト)、非晶質ポリオ レフィン、PPO(ポリフェニレン オキサイド)、 PV C (ポリ塩化ビニル)、ポリシクロ ヘキシルメタクリレート、フルオレン共重合ポリエステ ル等が挙げられる。 このうち、非晶質ポリオレフィンは 複屈折が生じ難く、 また、吸湿性が小さいため利用可能 な用途が広くなり好ましい。非晶質ポリオレフィンと は、環状構造を有する重合体であり、その構造、性質よ り非晶質ポリオレフィンと言える樹脂である。具体的な 非晶質ポリオレフィ ンの例としては、次のようなものが 挙げられる。

【0007】(A) シクロペンタジエンもしくはその誘導体とノルボルナジエンもしくはその誘導体との付加反応物と、ビニル基を有する化合物との共重合体又はその共重合体の水素添加物である。ここで、ビニル基を有す 40 る化合物とは、αーオレフィン、1、3ー共役ジエン、スチレン及びスチレン誘導体から選ばれた不飽和単量体である。αーオレフィンの具体例としては、エチレン、プロピレン、プチレン等が、1、3ー共役ジエンの具体例としては、ブタジエン、イソプレン、ペンタジエン等が、スチレン誘導体の具体例としては、ローメチルスチ

レン、mーメチルスチレン、pーメチルスチレン、 α ーメチルスチレン、oークロルスチレン、mークロルスチレン、pークロルスチレン、oーエチルスチレン、mーエチルスチレン、pーメトキシスチレン、pークロロエチルスチレン、pーメチルー α ーメチルスチレン等が挙げられる。なお、これらは 2 種類以上の混合物としても使用することができる。

[0008] (B) ジシクロペンタジエンもしくはその 誘導体とエチレンとの付加反応物と、上記ビニル基を有 10 する化合物との共重合体又はその共重合体の水素添加 物。

(C) 極性基を有するテトラー3ードデセンもしくはその誘導体又は/及び極性基を有するビシクロヘプトー2 ーエンもしくはその誘導体の開環重合体又はこれら開環 重合体の水素添加物。

【0009】 (D) 極性基を有するテトラー3ードデセンもしくはその誘導体又は/及び極性基を有するビシクロヘプトー2ーエンもしくはその誘導体と他の環状オレフィンとの開環重合体又はこれら開環重合体の水素添加物

以上において、(A) および(B) の非晶質ポリオレフィンとしては、下記一般式(3) で表される非晶質樹脂が例示できる。

[0010]

[化3]

20

$$\begin{pmatrix}
(X)_{d} & (CH_2 - CH_2)_{e} \\
 & R^7
\end{pmatrix} =$$
(3)

【0011】 [式(3)中、d及びeは互いに異なってもよく、1以上の整数をそれぞれ示す。 R 'は水素原子、炭化水素基又はC,H,R'基を表し、R'は水素原子、炭化水素基、アルコキシ基、ハロゲン化炭化水素基又はハロゲン原子を示す。炭化水素基はメチル基、エチル基等が挙げられる。また、Yはシクロベンタジエン、シクロベンタジエン誘導体、ノルボルナジエン、ノルボルナジエン誘導体、ジシクロベンタジエン、ジシクロベンタジエン及びこれらの水素添加物を示す。]

ここで、シクロペンタジエンないしその誘導体とノルボルナジエンないしその誘導体との付加反応物の水素添加物、又はジシクロペンタジエンないしその誘導体とエチレンとの付加反応物とは、下記一般式(4)で表されるものである。

[0012]

【化4】

【0013】 [式 (4) 中、fは0又は1の整数を示 す。gは0又は整数を示す。hは0又は1を示す、R' ~R''ならびにRaおよびRbは、それぞれ独立に水素原 子、ハロゲン原子及び炭化水素基よりなる群から選ばれ る原子又は基を表し、R15~R18は、互いに結合して単 環または多環を形成していてもよく、かつ、該単環また は多環が二重結合を有していてもよく、また、R゚゚゚とR ''とで、または R' * と R' * とでアルキリデン基を形成し ていてもよい。]

【0014】以上の式(4)で示される化合物として は、ビシクロ[2, 2, 1] ヘプトー2ーエン、テトラ シクロ [4, 4, 0, 1 *. *, 1 *. * *] ー 3 ードデセン、 ヘキサシクロ [6, 6, 1, 1'.',1''.'', 0'.',0 '・'']-4-ヘプタデセン、オクタシクロ[8,8, 0, $1^{1,1}$, $1^{4,7}$, $1^{11,14}$, $1^{11,16}$, $0^{1,4}$, $0^{1,17}$] — 5ードコセン、ペンタ シクロ [6 , 6 , 1 , 1 ^{1 · •} , 0 ^{1 · ·} , 0'''']-4-ヘキサデセン、ヘプタシクロ[8,8, 0, 1*.*, 1*.*, 1****, 0*.*, 0****]ー5ーエイコ セン、ペンタシクロ [6,5,1,11,6,01,7, 0': '']-4-ペンタデセン、ペンタシクロ[6,5, 1, 111,011]ー4, 10ーペンタデカジエン、トリ

シクロ[4,3,0,11.6]-3ーデセン、トリシクロ [4, 4, 0, 12, 5]-3-ウンデセン、ペンタシ クロ [7, 4, 0, 1 *・・・・, 1 *・・・・ , 0 *・・・・] ー 3 ーペンタ デセン、ヘプタシクロ [8, 7, 0, 1'・・, 1'゚・', 1 '¹''', 0[']'', 0^{''}''] ー4ーエイコセン、ペンタシク ロ [8, 4, 0, 1'.', 1'.'', 0'.'']ー3ーヘキサデ セン、ヘプタシクロ[8, 8, 0, 1 *. *, 1 * * *, 1 ''.'', 0'.', 0''.'']ー5ーヘンエイコセン、イナシク \square [10, 9, 1, 1^{4.7}, 1^{11.10}, 1^{11.11}, 0^{7.11}, 0 ¹・¹, 0 '¹・¹', 0 '¹・'¹] - 5 - ペンタコセン、ノナシクロ $[10, 10, 1, 1^{i+1}, 1^{i+1}, 1^{i+1}, 0^{2-i}, 0]$ *・*,0'*・**,0'*・**]-5-ヘキサコセン等、及びこれ らの骨格に次のような置換基を有した誘導体が挙げられ る。置換基として、塩素基、臭素基、フッ素基、メチル 基、エチル基、プロピル基、フェニル基、ナフチル基、 ブチル基、シクロヘキシル基、エチリデン基、プロピリ デン基、ペンジル基等が挙げられる。

【0015】次に、(C) の非晶質ポリオレフィンとし ては、例えば、下記一般式(5)で表される非晶質重合 体が挙げられる。

【0016】 [式 (5) 中、j及びkは互いに異なって もよく0又は1以上の正の整数を示す。また、環状5員 環単位には、ハロゲン原子又は炭化水素基等の置換基を 有していてもよい]

極性基を有するテトラシクロ [4,4,0,1'.',1 ··''] -3ードデセンもしくは誘導体及び極性基を有す

るビシクロ [2、2、1] ヘプトー2ーエンもしくは誘 導体としては、下記一般式(6)で表されるものであ

[0017]

[化6]

$$\begin{array}{c|c}
R_{c3} & R_{c5} \\
R_{c4} & R_{c7} \\
R_{c4} & R_{c6} \\
R_{c4} & R_{c6} \\
R_{c6} & R_{c6}
\end{array}$$
(6)

[0018] [式(6) 中、mは0又は1を示す。R'' ~R¹は互いに異なって もよく、カルポキシ ル基、アセ トキシ基、シアノ基、ハ ロゲン原子、水素原 子、 炭化水 素基より選ばれる置換基 を表す。 R´' ~ R´゚ は互いに異 なってもよく、水素原子 、ハロゲン原子、炭 化水素基よ りなる群から選ばれる。 炭化水素基は、メチ ル基、エチ ル基、プロピル基、フェ ニル基、ナフチル基 、 ブチル 基、シクロヘキシル基、 エチリデン基、プロ ピリデン 基、ペンジル基等が挙げられる。]

【0019】 (D) の非晶質ポリオレフィンとは、前記 一般式(6)と他の環状オレフィンとの開環重合体又は 20 着性が良好であり、特に好ましい。 その水素添加物である。 ここで、他の環状才 レフィンの 具体例としては、シクロ ペンテン、シクロオ クテン、 1, 5-シクロオクテンタジエン、1, 5, 9-シクル ドデカトリエン等のシク ロオレフィン、ビシ クロヘプト -2-エン、トリシクロー3ーデセン、トリシクロー9 ーウンデセン、テトラシクロー3ードデセン、 ペンタシ

クロー4ーペンタデセン、ペンタシクロー4 ーヘキサデ セン等のポリシクロアルケンが挙げられる。 本発明にお ける非晶質ポリオレフィンは、1種又は2種以上の混合 物を使用してもよい。

【0020】更に、非晶質ポリオレフィンの中でも、

(C) 極性基を有するテトラー3ードデセン もしくはそ

R 3 1 R 3 2

【0023】[式(7)中、R"及びR"は互いに異な 40 ってもよく、水素又はメチル基を示す。R ³ ³ は炭素数 5 0以下の脂肪族基、脂環式基、芳香族基及びその基の中 にS、N、O、Si、P、Fから選ばれる元素が含有し てもよい。]

このうち、下記の一般式(1)で示される含イオウビス (メタ) アクリレート及び一般式(2) で示される脂環

10 の誘導体又は/及び極性基を有するビシクロヘプトー2 ーエンもしくはその誘導体の開環重合体又はこれら開環 重合体の水素添加物と、(D)極性基を有するテトラー 3ードデセンもしくはその誘導体又は/及び極性基を有 するビシクロヘプトー2ーエンもしくはその誘導体と他 の環状オレフィンとの開環重合体又はこれら開環重合体 の水素添加物が、光ディスク基板、プラスチック液晶基 板、プラスチックカラーフィルムター、プラスチック太 陽電池基板、タッチパネル等の部材として使用する際 に、有機物又は無機物の蒸着及び塗布等の加工の際の密

【0021】この場合、具体的な蒸着とは、SiO、I TO、SiO,、Al等の薄膜の形成であり、塗布加工 とは、例えばEVOH、PVDC等のパリア性樹脂のコ ーティングやカラー色素のコーティングが挙げられる。 本発明の樹脂組成物のもう1つの成分は活性エネルギー 線により硬化するピス (メタ) アクリレートである。活 性エネルギー線により硬化するピス(メタ)アクリレー トは、下記一般式 (7) で示され、活性エネルギー線に より硬化して樹脂となる。

[0022] 30 【化7】

> 骨格ビス(メタ)アクリレートより選ばれる少なくとも 1種のピス (メタ) アクリレートよりなる組成物が耐薬 品性、剛性等の面で好ましい。なお、「(メタ)アクリ レート」は、アクリレートないしメタクリレートを総称 するものである。

(7)

[0024]

[化8]

【0025】 [式 (1) 中、R'及びR'は、互いに異な ってもよく、水素原 子又 はメチル基を示す。 R ¹ 及び R ¹ は、互いに異なってもよ く、炭素鎖中に酸素原子及び/ 又は硫黄原子を有しても よい炭素数1~6の炭化水素基 を示す。Xはハロゲン原 子又は炭素数1~6のアルキル 基及び炭素数1~6のアルコキシ基から選ばれた置換基 を示し、aは0~4の整数を示す。但し、aが2以上の 整数の場合には、複数のX は互いに異なってもよい。] [0026]

【化9】

$$CH_{2} = C - C - C - CH_{2}$$

$$CH_{2} - D - C - C - C - CH_{2}$$

$$0$$
(2)

「式 (2) 中、R'及びR'は、互いに異なってもよく、 水素原子又はメチル 基を 示す。 b は 1 又は 2 を示し、 c は0又は1を示す。]

【0027】上記の一般 式(1)に示される含イオウビ ス (メタ) アクリレート 化合物の具体例としては、例え ば、p - ビス(β - メタ クリロイルオキシエチルチオ) キシリレン(R': メチノル、R': メチル、R': エチレ ン、R':メチレン、 1 : 0)、p-ピス(β-アクリ ロイルオキシエチルチオ) キシリレン、m-ビス (β-メタクリロイルオキ シエ チルチオ) キシリレン、m – ビ ス (β – アクリロイ ルオ キシエチルチオ)キシリレン、 ρ – ビス (β – メタクリ ロイルオキシエチルオキシエチ ルチオ) キシリレン、ρ ーピス (βーメタクリロイルオ キシエチルチオエチルチオ キシリレン、p-ピス(- メタクリロイルオキシ エチルチオ)テトラブロムキシ リレン、m-ビス (β 一 メタクリロイルオキシエチルチ オ) テトラクロロキシリ レンなどが挙げられる。これら の化合物は、例えば特開昭62-195357号公報に 示されている手法で合成することができる。

【0028】上記の一般式(2)に示される脂環骨格ビ ス (メタ) アクリレート 化合物の具体例としては、ピス (オキシメチル) トリシクロ[5.2.1.01.6] デ カン=ジアクリレート、 ピス(オキシメチル) トリシク ロ [5. 2. 1. 0^{***}] デカン=ジメタクリレート、 ピス (オキシメチル) トリシクロ [5.2.1. 0'.'] デカン=アクリ レートメタクリレート及びこれ らの混合物、ビス (オキシメチル) ペンタシクロ [6. 5. 1. 1*・1. 0 *・1. 0 *・1] ペンタデカン=ジアク リレート、ピス (オキシメチル) ペンタシクロ [6.

5. 1. 1'.' . 0'.'. O'.''] ペンタデカ ン=ジメ タクリレート、ビス(オキ シメチル) ベンタ シクロ [6.5.1.1**'、0***'、0'***] ペンタデカン= アクリレートメタクリレー ト及びこれらの混合物があ る。これらのトリシクロデ カン化合物及びペンタシクロ ベンタデカン化合物は、群内及び(又は)群間で2種以 上併用してもよいこれらの 化合物は、例えば、 特開昭 6 2-225508号公報に 示されている手法 で合成する ことができる。

【0029】一般式(1) 及び(2)で示されるビス (メタ) アクリレートは、 単独もしくは2種以上を併用 して用いることができる。 一般式(1)の化合物を単独 で用いる場合、活性エネル ギー線により硬化 した樹脂組 成物の屈折率は、ナトリウ ムのD線 (589.3nm) において室温で1.54~1.65となり、高屈折率を 有する。また、一般式(2) の化合物を単独 で用いる場 合は比較的低い屈折率1. 47~1.51となる。従っ て、一般式(1)及び(2)で示される化合物を2種以 上併用することにより、 1 . 47~1.65の間で所望 の屈折率を有する活性エネルギー線により硬化した樹脂 組成物を得ることができる。また、以上の一般式(1) 及び(2)で示されるピス(メタ)アクリレートは、そ れ単独で重合させて使用することができるが、一般式 (8)、(9)及び(10)で示される分子内に2個以 上のチオール基を有する メ ルカプト化合物よ り選ばれる 少なくとも1種のメルカプト化合物を配合することによ り複屈折の低減、適度の収性を付与することもできる。 [0030]

【化10】

$$(HS - R^{34} - C - O \rightarrow R^{35})$$
(8)

40

[式 (8) 中、複数の R^{**} は互に異っていてもよく、 50 それぞれメチレン基又はxチレン基を示す。 R^{**} は炭

素鎖中に酸素原子及び / 又 は硫黄原子を含んでいてもよ い炭素数2~15の炭化水素残基を示す。nは2~6の 整数を示す。〕

[0031]

【化11】

$$\begin{array}{c|c}
 & z \\
 & N \\
 & C \\$$

[式 (9) 中、Zは互に異っていてもよく、H S - (C H_{1}), - (CO) (OCH, -CH,), - (CH,) ,-を示す。但しrは1~4の整数、sは1~ 4 の整 数、tは0~2の整数をそれぞれ示す。] [0032] 【化12】

12

$$H S - R_0^{35} \leftarrow \begin{array}{c} & & \\ & \\ \end{array} + \begin{array}{c} R_0^{37} - S \xrightarrow{Q} H \end{array}$$
 (10)

[式 (10) 中、R**及びR**は、互いに異っていても よく、炭素数1~3の炭 化水素基を示す。o及びpはそ れぞれ0又は1を示す。 aは1又は2を示す。]

【0033】上記の一般 式(8)で示されるメルカプタ ン化合物は、2~6 価の チオグリコール酸エステル又は チオプロピオン酸エステ ルである。具体例としては、例 えばペンタエリスリ トー ルテトラキス(β – チオプロピ オネート)、ペンタエリ スリトールテトラキス(チオグ リコレート)、トリメチ ロールプロパントリス (β - チ オプロピオネート)、ト リメチロールプロパントリス (チオグリコレート) 、 ジエチレングリコールビス (β ーチオプロピオネート)、ジエチレングリコールビス (チオグリコレート)、 トリエチレングリコールビス (β-チオプロピオネート)、トリエチレングリコール ビス(チオグリコレート)、ジペンタエリスリトールへ キサキス (β-チオプロ ピオネート)、ジペンタエリス リトールヘキサキス (チオグリコレート) などが挙げら れる。

【0034】上記の一般式(9)で示される化合物は、 ω-SH基含有トリイソ シアヌレートである。具体例と しては、例えば、トリス [2-(β-チオプロピオニル オキシ) エチル] トリイ ソシアヌレート、トリス(2 -チオグリコニルオキ シエ チル)トリイソシアヌレート、 トリス [2-(β-チオ プロピオニルオキシエトキシ) エチル] トリイソシアヌ レート、トリス(2 -チオグリ コニルオキシエトキ シエ チル) トリイソシアヌレート、 トリス [3-(β-チオプロピオニルオキシ)プロピ ル] トリイソシアヌレート、トリス(3-チオグリコニ ルオキシプロピル) トリ イソシアヌレートなどが挙げら れる。上記の一般式 (10) で示される化合物は α , ω - S H基含有化合物である。具体例としては、例えばべ ンゼンジメルカプタン、 キシリレンジメルカプタン、 4, 4′-ジメルカプト ジフェニルスルフィドなどが挙 げられる。

【0035】更に、このピス (メタ) アクリ レートに は、上記メルカプト化合物のほかにピス(メ 夕) アクリ レート100重量部に対して30重量部程度までの量で ラジカル重合可能な他の単量体を混合して共 重 合させて 製造することも可能である。この際に用いる 他 の単量体 としては、例えば、メチル(メタ)アクリレー ト、フェ ニル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ 工 チル(メ タ) アクリレート、メタクリロイルオキシメ チ ルテトラ シクロドデカン、メタクリロイルオキシメチ ルテトラシ クロドデセン、エチレングリコールジ(メタ) アクリレ ート、ジエチレングリコールジ(メタ)アク リ レート、 1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、 2, 2-ピス [4-(β-メタクリロイルオ キシエトキ シ) フェニル] プロパン、2, 2′-ビス [4-(β-メタクリロイルオキシエトキシ) シクロヘキ シル] プロ パン、1,4-ピス(メタクリロイルオキシ メ チル)シ クロヘキサン、トリメチロールプロパントリ (メタ)ア クリレート等の(メタ)アクリレート化合物、 スチレ ン、クロルスチレン、ジビニルベンゼン、lpha - メチルス チレン等の核及び(又は)側鎖置換及び非置 換 スチレン などが挙げられる。これらの他の単量体の中でもメタク リロイルオキシメチルシクロドデカン、2, 2 -ビス [4-(β-メタクリロイルオキシエトキシ) フェニ 40 ル] プロパン、2, 2-ビス [4-(β-メ タクリロイ ルオキシエトキシ)シクロヘキシル]プロパン、1,4 - ピス(メタクリロイルオキシメチル)シク ロヘキサ ン、及びこれらの混合物が特に好ましい。 更 に 、これら には、少量の酸化防止剤、紫外線吸収剤、染 顔料、充填 剤等を含んでいてもよい。

【0036】本発明の樹脂組成物を構成する 非晶質熱可 塑性樹脂と活性エネルギー線により硬化する ピス(メ タ)アクリレートとの混合割合は、非晶質熱 可塑性樹脂 99~~1重量%と活性エネルギー線により 硬化するビ 50 ス (メタ) アクリレート1~99重量%である。活性エ 10

14

ネルギー線により硬化する ピス (メタ) アクリレートが 1重量%未満であると耐薬品性の効果が得られず、99 重量%を越えると強靱性力⁵低下するので好ましくない。 好ましくは、活性エネルギー線により硬化するビス(メ タ)アクリレートが10~95重量%である。また、非 晶質熱可塑性樹脂の屈折率なとビス(メタ)アクリレート を活性エネルギー線によ り 硬化した樹脂の屈折率との差 が0.05以下、特に0.03以下であることが好まし い。屈折率の差が0.05を越えると透明性が低下する ため、このような目的の月日途には使用できない傾向にあ る。なお、この屈折率の測定は、25℃、波長589. 3 nm (ナトリウム D線) の条件下での測定結果であ る。

【0037】本発明の樹脂組成物は、活性エネルギー線 により硬化させて部材とたる。活性エネルギー線とは、 紫外線、電子線等が挙げ られる。部材の成型方法は、非 晶質熱可塑性樹脂と活性 エネルギー線により硬化するビ ス(メタ)アクリレート との樹脂組成物の粘度に合わせ て加工方法を選択することができる。例えば、樹脂組成 物を押出成形した後、 活 1生エネルギー線で硬化すること により成形する、樹脂組成物を溶媒に溶かしたものをキ ャストし、溶媒を蒸発さ せた後、活性エネルギー線で硬 化させることにより成形でする、また混合物の流動性が大 きい場合は、直接ロール 又はベルトにキャストさせる、 又は研磨ガラス等よりな る少なくとも一面が活性エネル ギー線を透過可能な2枚の相対する平板を用い、スペー サー等によりキャピティ を形成させ周辺部をシールして なる注入型に注入して、 活性エネルギー線で硬化させる ことにより成形することができる。

【0038】活性エネル ギー線で硬化させた部材が、ア イソット衝撃強度 0.5 kgf・cm/cm以上である と強靱性に優れ好ましい 傾向にあり、また平行光線透過 率が80%以上であると、シート状又はフィルム状部材 として透明性に優れ好ま しい傾向にある。活性エネルギ 一線の照射量は樹脂組成 物を硬化させる量であればよ い。部材は、透明板、光 学レンズ、光ディスク基板、プ ラスチック液晶基板、プ ラスチックカラーフィルタ、プ ラスチック太陽電池基板 、タッチパネル、光学素子等の ガラス基板に代えて使用 する場合は、シート状又はフィ ルム状のものが好ましい 。この場合、シート状又はフィ ルム状とは、長尺のもの に限らず、短尺の平板状のもの も含まれる。

【0039】活性エネル ギー線が紫外線の場合は、例え ば、ラジカルを発生する 光重合開始剤を添加する公知の ラジカル重合により硬化 させる。光重合開始剤として は、例えばペンソフェノ ン、ペンゾインメチルエーテ ル、ベンゾインイソプロ ピルエーテル、ジエトキシアセ トフェノン、1-ヒドロ キシシクロヘキシルフェニルケ トン、2、6-ジメチル ペンゾイルジフェニルホスフィ ンオキシド、2, 4, 6 ートリメチルベンゾイルジフェ

ニルホスフィンオキシド等が挙げられる。好ま しい光開 始剤としては、2,4,6-トリメチルペンプ イルジフ ェニルホスフィンオキシド、ベンゾフェノンで ある。こ れら光重合開始剤は2種以上を併用してもよい。

【0040】光重合開始剤の添加量は、ピス (メタ)ア クリレート100重量部に対し、通常0.01 ~1重量 部、好ましくは0.02~0.3重量部である。 光重合 開始剤の添加量が多すぎると、重合が急激に進 行し複屈 折の増大をもたらすだけでなく色相も悪化する。 また少 なすぎると組成物を充分に硬化させることがで きなくな る。 照射する活性エネルギー線の量は、光重と合開始剤 がラジカルを発生する範囲であれば任意である が、極端 に少ない場合は重合が不完全なため硬化物の而す熱性、機 械特性が十分に発現されず、逆に極端に過剰なよ 場合には 硬化物の黄変等の光による劣化を生じるので、 モノマー の組成及び光重合開始剤の種類、量に合わせで 200~ 400 n m の紫外線を、好ましくは0.1~200 J の 範囲で照射する。使用するランプの具体例とし ては、メ タルハライドランプ、高圧水銀灯ランプ等を挙 げること ができる。

【0041】硬化をすみやかに完了させる目的で、熱重 合を併用してもよい。すなわち光照射と同時1ご組成物並 びに型全体を通常30~300℃の範囲で加索をする。こ の場合は重合をよりよく完結するためにラジプ ル重合開 始剤を添加してもよいが、過剰な使用は複屈 折 の増大と 色相の悪化をもたらす。熱重合開始剤の具体を列としては ベンゾイルパーオキシド、ジイソプロピルパー オキシカ ーポネート、t ープチルパーオキシ(2 –エ*ヨ*チルヘキサ ノエート)等が挙げられ、使用量はモノマー 1 00重量 部に対して1重量部以下が好ましい。更に、本発明にお いて光照射によるラジカル重合を行った後、 **石**更 化物を加 熱することにより重合反応の完結及び重合時(そこ発生する 内部歪を低減することも可能である。加熱温上度は、硬化 物の組成やガラス転移温度に合わせて適宜選 #17 される が、過剰な加熱は硬化物の色相悪化をもたらっすため、ガ ラス転移温度付近かそれ以下の温度が好まし ひ1。

[0042]

50

【実施例】以下、本発明の内容および効果を 実 施例によ り更に詳細に説明するが、本発明は、その要 旨 を越えな い限り以下の例に限定されるものではない。 また、樹脂 組成物及び部材の評価は、以下の方法により 2側 定した。 〈平行光線透過率〉実施例及び比較例により 7号 られた部 材を、JIS-K7105に準拠し、大きさ 5 cm×5 cm×1mmの試験片とし、スガ試験機械 (株) 製のH GM-2DPを用い、平行光線透過率(%) を測定し

【0043】〈耐薬品性〉実施例及び比較例 により得ら れた部材を大きさ1cm×1cm×1mmの 試験片と し、該試験片を25℃のキシレンに24hr 入れ、外観 の腐食、溶解の状況を観察し、外観の変化の ないもの:

20

15

○、膨潤、白化を生じた も の:△、樹脂が溶解し、形状をとどめないもの:×、 と した。

【0044】製造例1

【0045】上記反応物 100重量部をテトラヒドロフラン2000重量部に溶解し、これに触媒として活性炭に担持させたパラジウム (5%濃度パラジウム)10重量%を加え、仕込み水素圧を150kg/cm²とし、150℃で4時間水素添加反応をおこなった。冷却後、容器中の水素ガスを放圧し、更に反応溶液から触媒を適過した後メタノールを添加して、水素添加重合体である極性基を有する非晶性ポリオレフィンを得た。この重合体の屈折率は1.51、ガラス転移温度Tgは168℃、固有粘度は0.48 d1/g(30℃クロロホルム中)及び密度は1.06 g/cm³であった。

【0046】実施例1

製造例1で重合した極性基を有する非晶性ポリオレフィン100gを塩化メチレン200gに溶かし、その中に、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0 1・1] デカン=ジメタクリレート100g(硬化後の屈折率1.49)、光開始剤として2,4,6ートリメチルペンゾイルジフェニルフォスフィンオキシド(BAS 40 F社製「ルシリンTPO」)0.05g、ペンゾフェノン0.05gを均一に攪拌混合した後、塩化メチレンを飛ばして樹脂組成物を得た。この樹脂組成物を、スペーサーとして厚さ1mmのシリコン板を用いた光学研磨ガラスの型に注入し、ガラス面上に在る出力80W/cmのメタルハライドランプにて、40J/cm¹のエネルギーになるよう約20分間照射した。照射後ガラス型を離型し硬化物の厚さ1mmの部材を得た。得られた部材について評価結果を表1に示した。

【0047】 実施例 2

製造例1で重合した極性基を有する非晶性ボリオレフィン200gを塩化メチレン200gに溶かし、 その中に、ビス(オキシメチル)トリシクロ [5.2.1.0 いっぱっぱ デカン=ジメタクリレート800g(硬 化後の屈折率1.49)、光開始剤として2,4,6 一 トリメチルペンゾイルジフェニルフォスフィンオキシド (BASF社製「ルシリンTPO」)0.4g、ペンゾフェテアとでででは投控混合した後、この混合物を室出気中にある金属ベルトにキャストしたシートに、出力80W/cmのメタルハライドランプにて、上面から40J/cm'のエネルギーになるよう約5分間 照射した。厚さ1mmの硬化したシート(部材)を得た。得られた部材について評価結果を表1に示した。・

16

【0048】 実施例3

実施例1において、樹脂組成物を、非晶性ポリオレフィンとして、日本ゼオン(株)製、ゼオネックス 450、屈折率1.53のもの20gをキシレン40gに溶かし、その中に、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0''] デカン=ジメタクリレート980g(硬化後の屈折率1.49)、光開始剤として2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルフォス フィンオキシド(BASF社製「ルシリンTPO」)0.5g、ベンゾフェノン0.5gに代えたほかは、同例と同様に部材を得た。得られた部材について評価結果を表1に示した。

[0049] 実施例4

ポリアリレート樹脂(鐘淵化学(株)製、エリメック、屈折率1.60)100gを塩化メチレン1 O 0gに溶かし、その中に、pービス(βーメタクリロイルオキシエチルチオ)キシリレン900g(硬化後の屈折率1.60)、光開始剤として2,4,6ートリメチルペンソイルジフェニルフォスフィンオキシド(BASF社製「ルシリンTPO」)0.5g、ペンソフェノシ0.5gを均一に攪拌混合した後、この混合物を窒素雰囲でである金属ベルトにキャストしたシートに、80℃で乾燥がに入れ溶媒を蒸発乾燥させた後、出力80℃ででのメタルハライドランプにて、上面から30 J/cm*のエネルギーになるよう約5分間照射した。厚さ1mmの硬化したシート(部材)を得た。得られた部材について評価結果を表1に示した。

【0050】 実施例5

実施例1において、樹脂組成物を、ポリメチ ルメタクリレート樹脂 (三菱レーヨン (株) 製、アクリペットV、屈折率1.49)50gを塩化メチレン50gに溶かし、その中に、ピス (オキシメチル)トリシ クロ [5.2.1.0''] デカン=ジメタクリレート950g (硬化後の屈折率1.49)、光開始剤として2,4,6ートリメチルペンゾイルジフェニルフォス フィンオキシド (BASF社製「ルシリンTPO」)0.5g、ペンゾフェノン0.5gに代えたほかは、同例と同様に部

17

材を得た。得られた部材について評価結果を表1に示し た。

【0051】 実施例 6

実施例1において、樹脂組成物を、ポリカーポネート (三菱エンジニアプラス チックス (株) 製、ユーピロン H-4000、屈折率1. 58) 50gを塩化メチレン 100gに溶かし、その中に、ビス (オキシメチル) ト リシクロ [5. 2. 1. O'-'] デカン=ジメタク リレ ート950g(硬化後の屈折率1.49)、光開始剤と して2,4,6-トリメ チルペンゾイルジフェニルフォ スフィンオキシド (BA SF社製「ルシリンTPO」) 0.5g、ペンソフェノン0.5gに代えたほかは、同 例と同様に部材を得た。 7得られた部材について評価 結果 を表1に示した。

[0052] 比較例1

製造例1で重合した極性基を有する非晶性ポリオレフィ ンを40mm押出機に幅 400mmのTダイスを取り付 けた設備で、310℃で押出し、150℃に加熱した4 00mm φのロールにキ ヤストして、厚さ1mm のシー トを得た。得られた部材について評価結果を表1に示し 20

た。

比較例 2

比較例1において、原料をポリカーポネート (三菱エン ジニアプラスチックス (株) 製、ユーピロン H ー 4 0 0 0、屈折率1.58) に代え、270℃で押出し、12 0℃に加熱した400mm φのロールにキャス トしたほ かは、同例と同様に厚さ1000μmのシート を得た。 得られた部材について評価結果を表1に示した。

[0053] 比較例3

実施例1において、樹脂組成物を、ピス(オキ シメチ ル) トリシクロ [5.2.1.0 $^{1.4}$] デカン = ジメタ クリレート1000g (硬化後の屈折率1. 49)、光 開始剤として2、4、6ートリメチルペンゾイ ルジフェ ニルフォスフィンオキシド (BASF社製「ル シリンT PO」) 0.5g、ベンゾフェノン0.5gを均一に混 合攪拌した組成物に代えたほかは、同例と同様 に部材を 得た。得られた部材について評価結果を表1に示した。 [0054]

【表 1 】

3女 1					
	A : B	屈折率差	平行光線透	耐薬	アイゾット衝撃強さ
	(重量%)		過率(%)	品性	(kgf·cm/cm)
実施例1	50:50	0.02	9 1	0	1. 2
実施例2	80:20	0.02	9 2	0	0.9
実施例3	2:98	0.04	9 2	0	0.8
実施例4	10:90	0.00	8 5	0	0.9
実施例 5	5:95	0.00	8 3	0	0.6
実施例6	5:95	0.09.	9	0	0.5
上上較例1	100:0	_	90	×	1 2
比較例2	100:0	_	9 2	×	3
比較例3	0:100	_	9 3	0	0.4

【0055】表1中、Aは非晶質熱可塑性樹脂、 Bは活 性エネルギー線により硬 化可能なビス(メタ)ア クリレ ートを示す。表1より、 本願発明の樹脂組成物および該 樹脂組成物よりなる部材は、耐薬品性に優れており、実 施例1と比較例3より、 非晶質熱可塑性樹脂のみの部材 40 に比較して、本発明の樹 脂組成物よりなる部材はアイゾ ット衝撃強さが大きいこ とがわかる。

[0056]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物は、ガラス基板に代 えて液晶基板、太陽電池基板、タッチパネル、 光学素子 等の基板等に使用するために必要な耐薬品性 に優れてお り、該用途に使用する際、部材に成形するのが容易であ り、ガラス基板より衝撃強度においても優れている。ま た、該樹脂組成物のうち、屈折率の差が0.05以下で あると、耐薬品性に加え、透明性においても 良好であ り、該用途にはより好ましい。